

股票代码：002185

股票简称：华天科技

天水华天科技股份有限公司

Tianshui Huatian Technology Co., Ltd.

（甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号）



2018 年度配股公开发行证券 募集资金运用的可行性报告

二〇一八年十月

一、本次募集资金使用计划

为了进一步提升天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的综合实力，把握发展机遇，实现公司的发展战略，本次配股预计募集资金总额不超过人民币 170,000.00 万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金与偿还公司有息债务，其中：不超过 80,000 万元用于补充流动资金，不超过 90,000 万元用于偿还公司有息债务。

若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会及其授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次募集资金到位前，公司将根据有息债务的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金的必要性和合理性

（一）国家政策大力支持，国内集成电路产业保持快速增长

集成电路产业作为我国国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是培育发展战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础。为了促进我国集成电路产业的持续发展，突破和掌握核心技术，增强信息产业创新能力和竞争力，推进国民经济和社会信息化，国家推出一系列鼓励性政策，为集成电路产业的发展提供了良好的产业政策环境。2016年10月，国家工业和信息化部为贯彻落实《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》等文件精神，正式发布《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》。该规划明确要求着力提升集成电路设计水平，发展高端芯片，不断丰富知识产权IP核和设计工具，推动先进制造和特色制造工艺发展，提升封装测试产业的发展水平，形成关键制造装备和关键材料供货能力，加紧布局超越摩尔相关领域。

我国集成电路产业通过多年的快速发展，产业整体实力显著提升，对电子信息产业以及经济社会发展的支撑带动作用日益显现。根据中国半导体行业协会统计，国内集成电路产量从 2009 年的 414 亿块提高到 2017 年的 1564.9 亿块，

年复合增长率为 18.08%；销售额从 2009 年的 1,109.13 亿元提高到 2017 年的 5,411.3 亿元，年复合增长率为 21.91%。我国已成为全球集成电路产业增长最快的地区之一。集成电路产业的持续增长和巨大的市场需求带动了集成电路封装测试产业的快速发展。2017 年，在国内集成电路设计业订单与海外订单大幅增加的带动下，国内封装测试业继续保持较快增长，销售收入达到 1,889.7 亿元，同比增长 20.8%。

（二）公司业务扩张加大对流动资金的需求

公司所处的集成电路封装行业属于资本密集型行业，公司经营规模的逐步扩大需要更多的流动资金。2009 年-2017 年，公司经营规模持续增长，资产总额由 13.12 亿元增加至 93.66 亿元，年复合增长率 27.85%；产量由 32.67 亿块增加至 282.50 亿块，年复合增长率 30.95%；营业收入由 7.77 亿元增加到 70.10 亿元，年复合增长率 31.65%。总资产及营业收入的快速增长导致公司应收账款、存货等经营性资产大幅增加。截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款和存货分别为 8.75 亿元和 14.28 亿元，对流动资金形成较大的占用。此外，随着公司经营规模的扩张，公司生产经营所需的原材料采购成本、人力资源成本、动力运行成本等支出也相应增长，进一步增加了公司对流动资金的需求。因此，公司必须及时补充经营活动所需的流动资金，以满足不断扩张的业务需要。

（三）补充流动资金以满足发展需要，夯实公司发展资金基础

根据公司的经营战略和未来发展规划，为完善产业布局，加快公司业务发展，不断提升公司的盈利能力，必须要有充足的资金作为保障。公司未来三年流动资金需求缺口较大，本次配股募集资金中用于补充流动资金的金额不超过流动资金需求额。另外，2015 年至 2017 年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -15.24 亿元、-14.40 亿元和 -16.94 亿元，显示公司近几年处于快速发展的阶段，对资金的需要量较大。

随着市场竞争日趋激烈，客户对公司的产品升级、工艺提升等不断提出更高的要求，需要公司对研发进行持续的资金投入。2015 年-2017 年公司研发投入从 2.47 亿元快速增长到 3.53 亿元，年复合增长率达到 19.55%。持续增长的研

发投入及研发成果的产业化使公司在集成电路封测领域始终保持着技术领先优势。未来，公司的研发投入仍将保持增长。

（四）偿还有息债务以优化资本结构，增强公司抗风险能力

截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表资产负债率分别为 25.22%、28.29%、35.99%和 39.71%。随着业务规模的不断扩大，公司资产负债率持续上升，本次发行符合国家降杠杆政策，有利于缓解公司的资金需求压力，逐步降低资产负债率，增强公司防范财务风险的能力。募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模将进一步扩大，资本结构有所改善，有助于改善公司偿债指标，降低公司的财务风险，使公司资本结构更为稳健。

三、本次募集资金投向涉及的报批事项

本次配股募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还有息债务，不涉及报批事项。

四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对经营管理的影响

本次发行完成后，公司的资金实力将得到提升，进一步缓解公司流动资金压力，为公司各项经营活动的开展提供资金支持，有利于公司业务经营规模的持续稳定扩大，并将带动公司营业收入和净利润的增长，提升公司整体竞争力和可持续发展能力。

（二）对财务状况的影响

本次发行完成后，公司资本实力将得以显著增强，净资产和总资产相应增加，资本结构将进一步优化。公司营运资金得到有效补充，偿债压力得到缓解，有助于节省公司财务费用，降低公司财务风险，提高偿债能力，公司的经营规模和盈利能力将进一步提升，有利于实现全体股东利益的最大化。

五、结论

本次配股募集资金数量与发行人现有业务规模、实际资金需求、管理层资金运用能力和公司整体战略发展方向是基本匹配的，符合我国相关产业政策，顺应资本密集型行业发展趋势。本次发行完成后，公司资本实力将得以显著增强，财务状况将得到较大改善，盈利能力和抗风险能力将进一步提高。本次配股将有助于增强公司在行业中的核心竞争力，募集资金具有必要性和可行性，符合公司及全体股东的利益。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月十九日